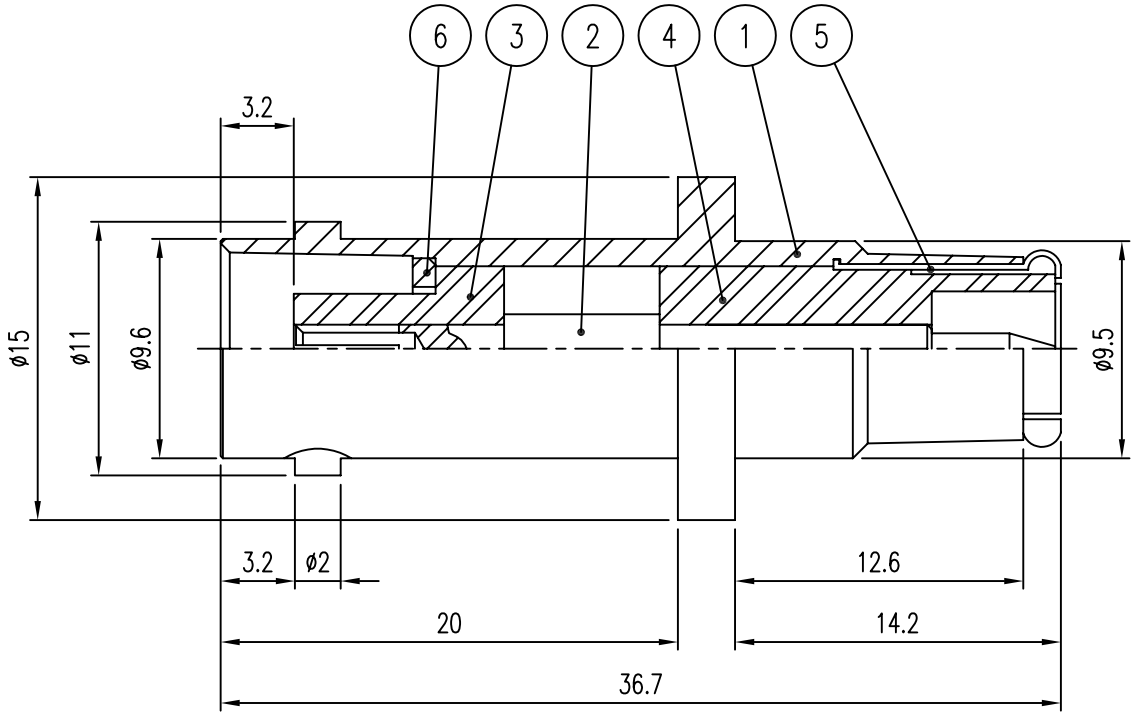
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	조립성 개선(INSULATOR변경)	손윤호	안병호	2003. 12. 27.



	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	6	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1 (L7009)
	5	JACK	1	BsS	Nickel Plate	DJA00039-5/1 (J6001)
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01163-N/1 (H6121)
1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00099-N/1 (H6128)
	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DAC00175-5/1 (EA211)
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00170-5/1 (DA229)

대체가능재질

공통공차 소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2003. 7. 29.
승인	
검도	
제도	
직성부서	연 구 소
척도	NS
단위	mm
중량	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 BNCJ-TRUP

A4

도번 AD00325-7/1

K361-534-000